

JEITA LPB-SC JEVeC DAY2021TG

活動報告

半導体&システム設計技術委員会
LPB-SC



JEVeC DAY2021TG 概要

● 目的

- JEVeC DAY2021の準備・当日対応
- MBSE研究会の講演による新しい活動の宣伝
- 技術展示によるLPB-SCの宣伝、参加企業の募集

● 期間

- 2021/08/06～2022/12/10

● 成果物

- JEVeC DAY2021イベントへの参加
- 講演による新しい活動の宣伝
- 技術展示によるLPB-SCの宣伝

活動報告

● 講演

タイトル：JEITA MBSE研究会の活動紹介とEMCフロントローディング設計フロー構築のケーススタディー

発表者：SD-TC 主査 福場 義憲

- 技術セミナー 11:30-11:50枠で発表
- リアル聴講者は約74名。アンケート:回答者数42名。うち23名が良かったと回答。(一般技術講演7社中2位)
- JEITA LPB-SCの新しい活動が宣伝できた。

活動報告

- リアル展示

タイトル：LPBフォーマットのご紹介

- ポスター3件を展示し、リーフレットを置いた。
- 展示員は置かず自由に見ていただく形式とした。(コロナ対策)

- オンライン展示(Gather展示)

- オンライン会場にポスターを展示し、質疑のために4名 + α待機した。
- Gatherという目新しいツールを利用したが、反応は薄かった。

JEVeC DAY 開催概要

名称 : JEVeC DAY 2021
日時 : 2021年11月8日(月) 9:50-17:50
主催 : 日本EDAベンチャー連絡会(JEVeC)
参加費 : 無料
講演 : リアル開催
技術展示 : ハイブリッド開催
URL : <https://www.jevec.jp/archive/jevecday2021/>

講演

15:50-16:10



福場義憲 氏

一般社団法人電子情報技術
産業協会 (JEITA)
半導体&システム設計
技術委員会 (SD-TC) 主査

技術セミナー

JEITA MBSE研究会の活動紹介とEMCフロントローディング設計フロー構築のケーススタディー

JEITAでは半導体と電子機器の協調開発を目指し、これまでに設計情報の円滑なやり取りでバリューチェーンを構成する取り組みをしてきました。これをさらに発展させるためにはバリューチェーン上の様々な当事者や開発チームの役割が明確化され、交換されるべき情報の意味や必要性、その詳細度などの取り決めなど意思の疎通が重要となります。誰もが容易に理解でき、正しく、容易にコミュニケーションができる手法としてMBSE (Model Based Systems Engineering)を活用する研究会を立ち上げました。当発表では電子機器のEMC特性を担保できる電子機器開発工程の構築をケーススタディーした実例を用いてJEITA MBSE 研究会の紹介を行います。

09:50-10:00	開会の挨拶 JEVeC 会長 株式会社ジエム・デザイン・テクノロジーズ 代表取締役 村田 洋	13:30-13:50	技術セミナー IoTプラットフォームへ組み込むSensor AFE LSIの開発とその適用 CMエンジニアリング株式会社 鈴木武志 氏
10:00-10:30	レポート 半導体・デジタル産業戦略と今後の政策の方向性 経済産業省 商務情報政策局 半導体室 室長 デバイス、半導体戦略室長 萩野洋平 氏	13:50-14:50	チュートリアル 半導体パッケージ実装と高密度基板 株式会社図研 長谷川清久 氏
10:30-11:00	講演セッション 半導体開発 - 先々の先を繋ぐ - 東京大学大学院 情報システムデザイン研究センターセンター長 先端システム研究組合 理事長 黒田忠広 教授	14:50-15:50	4 階展示場にて技術展示を行っていますので、ぜひご来場ください (開催時間: 11:40~16:30)。 ※一部企業はオンライン展示も行っていきます。こちらは Gather よりご参加ください。
11:00-11:20	技術セミナー PCB・ICパッケージ設計分野をカバーするトポロジベース自動配線 株式会社ジータット 営業本部 パートナープロダクト技術部長 六川裕卓 氏	15:50-16:10	技術セミナー JEITA MBSE研究会の活動紹介とEMCフロントローディング設計フロー構築のケーススタディー 一般社団法人電子情報技術産業協会 (JEITA) 半導体&システム設計技術委員会 (SD-TC) 主査 福場義憲 氏
11:20-11:40	技術セミナー 【新製品】半導体・メカ、実験の壁を取りのぞく新設計環境 MEMS Designer 株式会社図研 小林由一 氏	16:10-16:30	技術セミナー 派生開発を成功させるPLMの力 クイレックス・テクノロジー株式会社 経営企画本部長 遠藤俊二 氏
11:40-12:40	休 憩	16:30-17:40	特別招待講演 半導体を制するものが、世界を制する時代がやって来た！ ～日本はデバイス、装置、材料のクロスオーバーで勝負 株式会社産業タイムズ社 代表取締役会長 泉谷 渉 氏
12:40-13:10	レポート DMPのAI製品・技術の取り組みについてご紹介 株式会社デジタルメディアプロフェッショナル 開発部部長 橋又大壽 氏	17:40-17:50	閉会の挨拶 JEVeC 副会長 株式会社アストロン 代表取締役社長 中島義弘
13:10-13:30	技術セミナー 高位合成を活用したエッジAI処理の高速化 NEC システムデバイス事業部 中村寿彦 氏		

リアル技術展示

LPBフォーマットのポスター3件とリーフレットを展示



ポスター3件



リーフレット

